

## 高性能导热界面材料 (TIM) 用途

IceKap™ P30000 是一种不含硅胶的高性能导热界面材料，专用于 TIM 1.5 和 TIM 2 应用。在某些情况下，IceKap™ P30000 可用于 TIM 1 应用。

IceKap™ P30000 选用独特的聚合物，能够最大程度地提高系统性能。经过专门设计的聚合物材料体系：

- 能够最大程度地减少界面处的接触热阻，提供高导热能力
- 在 CPU 运行温度下，能够尽量减少流失或溢出
- 提供“连接点修复”功能
- 不含硅胶
- 易于返工，很容易从器件上剥离
- 能够经受数次回流焊接操作

IceKap™ P30000 可提前涂敷到组件上，然后妥善保存，以备将来发运至设备装配厂商。

## 特征与优点

- 非常高的导热性能
- 溢出极少
- 可靠性高
- 不含硅胶
- 连接点修复
- 易于返工
- 兼容回流焊接

## 市场/应用

- 半导体封装
- 显卡
- 笔记本电脑
- 台式电脑
- 服务器
- IGBT
- 汽车
- 内存模块
- 游戏机
- 机顶盒

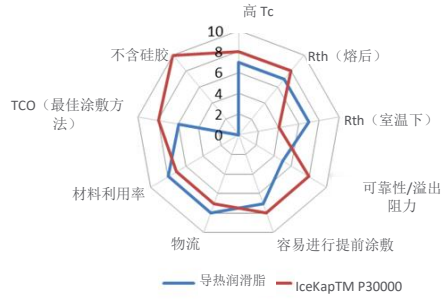
## 典型性质

典型性质	测试方法	
	IceKap™ P30000	
颜色	灰色	目测
比重 (g/cc)	2.5	氦比重仪
软化温度 (°C)	80 - 120	
最低 BLT (微米)	25	最大填料粒度
最低 BLT—推荐 (微米)	50	
最大连续使用温度 (°C)	125	莱尔德可靠性测试方法
导热系数 (W/mK)	5.5	热传导常数分析仪
热阻		
cm <sup>2</sup> °C/W	0.148	ASTM D5470, 在 10 psi & 70° C 下
in <sup>2</sup> °C/W	0.023	
耐回流焊接	最小 3x	IPC/JEDEC J-STD-020D.1
UL 防火等级	V-0 (进行中)	UL 94
厚度 (微米)	125、200、250	



美国: +1.866.928.8181  
欧洲: +49.8031.24600  
亚洲: +86.755.2714.1166  
[www.laird.com](http://www.laird.com)

价值定位（与导热膏相比）



价值定位（与导热相变材料相比）



美国: +1.866.928.8181  
 欧洲: +49.8031.24600  
 亚洲: +86.755.2714.1166  
[www.laird.com](http://www.laird.com)